

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

深圳中科飞测科技股份有限公司

（深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301-14 号 101、102）



中科飞测
SKYVERSE

2024年度向特定对象发行A股股票募集 资金使用可行性分析报告

二〇二四年十二月

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“中科飞测”或“公司”）是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本实力提升盈利能力根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票不超过 96,000,000 股（含本数），募集资金总额不超过 250,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目、总部基地及研发中心升级建设项目以及补充流动资金。

公司编制了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。

一、本次募集资金使用计划

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 250,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目	上海高端半导体质量控制设备产业化项目	84,572.98	73,400.00
		上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目	63,516.33	44,600.00
2	总部基地及研发中心升级建设项目		67,097.43	62,000.00
3	补充流动资金		70,000.00	70,000.00
合计			285,186.74	250,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解

决。

二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

本次募集资金投资项目包括上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目、总部基地及研发中心升级建设项目及补充流动资金。其中，上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目涉及上海高端半导体质量控制设备产业化项目和上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目两个子项目。上述募投项目方案概述及必要性、可行性分析如下：

（一）上海高端半导体质量控制设备产业化项目

1、项目基本情况

本项目拟在上海市浦东新区建设高标准洁净车间以及仓库等配套设施，引入先进的生产配套设备及软件，打造规模化、现代化、标准化的高端半导体质量控制设备产业化基地。本项目的实施将进一步缓解公司生产场地主要依赖租赁取得以及高端产品产能瓶颈问题，有效提升公司高端半导体质量控制设备产业化能力，充分满足下游客户的产品需求，助力推进高端半导体质量控制设备领域国产化进程。

2、项目实施必要性

（1）把握行业发展机遇，满足下游客户高端前沿工艺技术需求

随着半导体制程工艺的不断缩小、芯片内部结构的日趋复杂，以及应用在HBM等新兴领域的2.5D/3D先进封装技术的快速发展，行业发展对工艺控制水平愈发严苛，下游客户对高端半导体质量控制设备的技术要求及需求量持续提升。受益于我国半导体产业高端前沿工艺技术和进口替代加快，我国半导体质量控制设备产业正处于向高端前沿工艺全面迈进的阶段，高端半导体质量控制设备市场将迎来广阔的市场空间。

公司作为国内高端半导体质量控制设备行业领军企业，积极布局各细分类型高端前沿工艺设备研发领域，多系列新产品已完成样机研发，并出货客户开展产线工艺验证和应用开发。本次募投项目将重点提高明场纳米图形晶圆缺陷检测设

备、暗场纳米图形晶圆缺陷检测设备、光学关键尺寸量测设备等新产品系列，以及现有系列新一代产品的产业化能力，以满足我国高端半导体制造环节对质量控制设备的更高要求。

（2）提高高端前沿工艺设备产业化能力，支撑公司高质量可持续发展

目前，半导体质量控制设备领域，尤其是高端产品市场，主要市场份额仍被国外龙头厂商占据，国产化水平相对较低。2023 年度中国大陆半导体检测和量测设备市场呈现国外设备企业垄断的格局，主要企业包括科磊半导体、应用材料、雷泰光电等，其中，科磊半导体一家独大，市场份额占比为 64.29%，前五大公司合计市场份额占比为 84.52%，均为国外厂商，半导体质量控制设备国产化率水平亟需进一步提升。

公司已形成集成电路制造过程中所有关键环节所需的主要种类设备产品组合，具备给国内主流客户产线批量供货的能力，经营规模及市场地位持续提升，但在高端前沿工艺设备产品产业化能力依然有待提高。本次募投项目的实施将进一步缓解公司高端半导体质量控制设备产能瓶颈问题，提高交付能力，提升市场占有率，支撑公司高质量可持续发展。

（3）优化公司产品产能战略布局，支撑公司经营规模持续提升

公司自成立以来，始终坚持自主研发和自主创新，在多项半导体质量控制设备关键核心技术上达到国际领先水平，形成了集成电路制造过程中所有关键环节所需的主要种类设备产品组合，使得公司能够为不同类型的集成电路客户提供全面覆盖的检测和量测设备供应保障，支持客户的量产工艺需求和未来工艺研发需求。其中，公司六大系列设备已经在国内头部客户批量量产应用，技术指标全面满足国内主流客户工艺需求；另外三大系列设备均已完成样机研发，并出货客户开展产线工艺验证和应用开发。

公司现有产能主要集中于深圳市及大湾区，上海及长三角地区产能规划相对较少。上海及长三角地区作为我国半导体产业集群最为活跃的地区之一，是公司客户主要集聚区域之一。为了加快公司在上海以及长三角地区的战略规划实施，公司在上海新建产业化基地有利于充分利用区域优势，扩充长三角地区产能，提

高客户需求响应速度及产品交付效率，增强客户粘性，从而巩固并提高公司行业市场地位和市场份额。

3、项目实施可行性

(1) 广阔的下游市场空间为项目实施提供了市场基础

半导体行业作为现代信息技术产业的基石，拥有庞大的产业规模和持续的增长潜力。近年来，随着下游电子、汽车、通信等行业需求的稳步增长，以及人工智能、云计算及大数据等新兴领域的快速发展，为半导体设备行业带来广阔的市场空间。根据 SEMI 预测，2024 年半导体制造设备全球总销售额预计将达到 1,090 亿美元，同比增长 3.4%，2025 年将达到 1,280 亿美元，预计增长率将超过 17.4%。

目前中国大陆已成为全球最大的半导体设备市场。根据 SEMI 统计，2023 年中国大陆半导体设备市场销售额达到 366.6 亿美元，同比增长 29.7%，自 2020 年以来连续四年成为全球第一大半导体设备市场。质量控制设备作为集成电路生产过程中的核心设备之一，拥有广阔的市场空间。根据 VLSI 数据统计，2023 年我国半导体检测与量测设备市场规模为 43.60 亿美元。随着我国半导体各环节新建产能快速扩张，并向高端前沿工艺方向持续升级，公司作为国内半导体质量控制设备行业领军企业必将充分受益。

(2) 优质的客户资源为项目实施提供坚实保障

公司长期深耕高端半导体质量控制领域，坚持以客户需求为导向，持续提升技术创新与产品创新能力，已经形成九大系列设备和三大系列软件的产品组合，可以为客户提供全方位的良率管理解决方案。其中，公司六大系列设备已经在国内头部客户批量量产应用，技术指标全面满足国内主流客户工艺需求；另外三大系列设备均已完成样机研发，并出货客户开展产线工艺验证和应用开发；三大系列智能软件已全部应用在国内头部客户。

目前，公司客户群体已广泛覆盖前道制程企业、化合物半导体企业、先进封装企业、半导体材料企业以及各类制程设备企业。其中，前道制程企业覆盖逻辑、存储、功率半导体、MEMS 等，化合物半导体企业覆盖碳化硅、氮化镓、砷化镓等，先进封装企业覆盖晶圆级封装和 2.5D/3D 封装等，半导体材料企业主要为

大硅片等，制程设备企业覆盖刻蚀设备、薄膜沉积设备、CMP 设备等。截至 2024 年 9 月末，公司累计客户数量超过 200 家。未来，公司将依托于优质的客户资源优势 and 口碑，积极拓展新客户资源，保障本次募投项目新建产能的有效消化。

(3) 强大的技术实力及储备为项目实施提供了坚实的技术基础

公司凭借优秀的技术研发团队、较强的技术创新能力以及多年技术积累，已经在高端半导体质量控制领域形成了强大的技术实力及储备，在行业竞争中拥有较强的技术优势。目前，公司已自主掌握深紫外成像扫描技术、高精度多模式干涉量测技术、基于参考区域对比的缺陷识别算法技术等高端半导体质量控制领域多项关键核心技术，上述核心技术成功应用于公司各系列产品。

公司高度重视优质研发资源的积累，尤其是行业优秀人才的引进以及高效、专业的研发团队的建设。截至 2024 年 9 月 30 日，公司研发人员数量为 493 人，构筑起了跨专业、多层次的人才梯队。凭借较强的技术实力和丰富的技术积累，截至 2024 年 9 月 30 日，公司已拥有境内外授权专利超过 500 项，其中发明专利超过 100 项。同时，公司牵头承担了多个国家级、省级、市级重点专项研发任务，参与了多项国家及国际标准的制定。公司强大的技术实力与储备以及构筑起的可持续的研发创新体系和能力将为项目实施提供了坚实的技术基础。

4、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为飞测思凯浦，计划投资总额 84,572.98 万元，其中拟投入募集资金 73,400.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资总额	占比	拟使用募集资金投资金额	占比
1	土地投资	3,257.66	3.85%	3,200.00	4.36%
2	建筑投资	65,501.63	77.45%	65,500.00	89.24%
3	设备及软件投资	4,741.96	5.61%	4,700.00	6.40%
4	预备费	3,512.18	4.15%	-	-
5	铺底流动资金	7,559.54	8.94%	-	-
合计		84,572.98	100.00%	73,400.00	100.00%

5、项目预计实施时间和整体进度安排

本项目的建设周期为 36 个月，包括项目前期准备及规划设计、工程施工、设备采购、设备安装调试、试运行生产等 5 个阶段，设公司开始投资当年为 T+1 年，具体时间进度安排如下：

项目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目前期准备及规划设计	■											
工程施工		■	■	■	■	■	■	■				
设备采购									■	■		
设备安装调试									■	■		
试运行生产										■	■	■

6、项目用地、涉及的审批、备案事项

本项目实施地点位于上海市浦东新区，建设地为新增土地。截至本预案公告日，相关用地、投资备案、环评（如需）等程序正在办理过程中。

（二）上海高端半导体质量控制设备研发测试中心项目

1、项目基本情况

本项目拟在上海市浦东新区建设研发测试中心，引入半导体质量控制技术研发与产品开发所需的先进软硬件设备，引进高端技术人才，进一步提升公司研发测试技术能力。本项目的实施将充分利用上海及长三角地区半导体高端产业、技术、人才等聚集优势，打造先进的研发测试中心，提升核心技术成果转化和产业化应用能力，推动公司产品技术不断升级迭代，以满足下游不同类型客户的工艺需求，持续增强公司核心竞争力。

2、项目实施必要性

（1）紧跟半导体质量控制行业发展趋势，全面深化公司技术布局

随着半导体制程工艺的不断缩小、芯片内部结构的日趋复杂，以及应用在 HBM 等新兴领域的 2.5D/3D 先进封装技术的快速发展，产品制程步骤越来越多，

微观结构逐渐复杂，生产成本呈指数级提升。为了保证尽量高的晶圆良品率，必须严格控制晶圆之间、同一晶圆上的工艺一致性，因此，客户对集成电路产品生产过程中的质量控制需求将越来越大。与此同时，未来半导体质量控制设备需在灵敏度、准确性、稳定性、吞吐量等指标上进一步提升，以保证每道工艺均落在容许的工艺窗口内，保证整条生产线平稳连续的运行。

多年来，公司始终致力于技术创新和产品性能提升，陆续推出了符合国内主流客户工艺需求的全流程良率管理解决方案。然而，半导体行业技术发展迅速，公司需顺应市场发展趋势和客户需求持续提升产品性能。本次募投项目的实施旨在建设打造更为先进的软硬件研发环境，紧跟行业主流技术发展方向，持续提高研发测试能力，推动公司设备产品及智能软件产品研发进程，不断提升产品性能和核心技术指标，形成完整的质量控制设备和智能软件相结合的良率管理闭环，以充分满足下游客户工艺制程及质量控制需求。

（2）充分利用上海及长三角半导体产业区位优势，提升公司技术创新能力

上海作为国际科技创新中心，集成电路是上海三大先导产业之一。作为国内集成电路产业发展的“领头羊”，上海汇聚了国内半导体行业大量产业优质人才和创新资源。在上海引领带动下，以上海为中心的长三角地区的协同发展进一步深化，目前，长三角已经发展形成国内产业链布局最完备、产业技术优势最突出的半导体产业集群之一，具有突出的政策优势、技术优势和人才优势。

本次募投项目的实施将充分利用上海及长三角地区产业集群资源、政策重点扶持、行业高端人才集聚、经济发展水平高、下游应用市场需求旺盛等区位优势，吸引优质技术人才，不断完善升级公司研发测试中心，进一步推动公司产品技术的创新发展，夯实公司核心技术护城河。

（3）提升公司研发测试能力，巩固市场竞争地位

半导体质量控制设备行业为技术密集型行业，涉及光学、算法、软件、机电自动化控制等多学科、多领域知识的综合运用，具有较高的技术和客户验证壁垒。目前，受限于场地等因素限制，公司经营场地主要用于生产和研发活动，尚未涉及设备研发测试专用场地，难以满足公司业务需求，对公司技术创新及业务持续

增长形成一定的制约。

本次募投项目将打造先进的自主研发测试中心，为公司产品从研发设计到产业化提供全面的研发测试功能支撑。公司通过打造先进的研发测试中心将有助于加快核心技术成果转化和产业化应用，不断提高产品的覆盖广度和深度，持续推出满足更多不同类型客户工艺需求的高端半导体质量控制解决方案，以技术创新引领公司未来发展，巩固和提升市场竞争地位。

3、项目实施可行性

（1）国家产业政策的大力支持为项目实施提供政策基础

半导体产业是现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是当前衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志。近年来，国家出台一系列鼓励扶持政策，为半导体设备产业的高质量发展提供有力支持。

近年来，国家国务院、工信部等部门陆续出台《“十四五”数字经济发展规划》《智能检测装备产业发展行动计划（2023—2025年）》《关于印发电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案的通知》《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》等产业政策，均提出补强增强半导体产业链，尤其是提高半导体检测设备自主供给能力。公司所处行业为半导体质量控制设备行业，将充分受益于上述产业政策的大力鼓励与支持，为公司业务发展及本次募投项目的实施打下了坚实的政策基础。

（2）较强的技术实力和丰富的技术储备为项目实施提供技术基础

公司一直以来高度重视技术研发资源的积累，尤其是行业优秀人才的引进以及高效、专业的研发团队的建设。公司培养和吸引了一大批经验丰富的光学、算法、软件、机电自动化等方面的专家，构成公司研发的中坚力量。截至2024年9月30日，公司研发人员数量为493人，构筑起了跨专业、多层次的人才梯队。与此同时，凭借较强的研发实力，公司牵头承担了多个国家级、省级、市级重点专项研发任务，不断助力国内集成电路产业领域关键产品和技术的攻关与突破，进一步巩固并提升了公司的技术实力和竞争优势。

凭借持续的技术创新和积累，公司核心技术体系已经实现了自设备到智能软

件产品的半导体质量控制领域全流程全覆盖，已自主掌握深紫外成像扫描技术、高精度多模式干涉量测技术、基于参考区域对比的缺陷识别算法技术等高端半导体质量控制领域多项核心技术，积累了丰富的技术成果，公司强大的技术实力与储备以及构筑起的可持续的研发创新体系和能力将为本项目的顺利实施提供技术支持和技术保障。

(3) 科学完善的研发管理体系为项目实施提供重要保障

完善、科学的技术研发体系架构及研发制度，是保证技术研发活动正常开展，激发技术研发人员活力的基础。作为技术创新驱动的半导体质量控制设备企业，公司重视研发体系的搭建以及相关制度的落实。在研发体系建设方面，自成立以来，公司坚持自主研发、自主创新的研发模式，根据公司各业务板块的特点结合行业内技术发展趋势，并考虑研发活动的开展效率，已逐步构建起了一套集研发、生产、销售于一体的创新机制。同时，公司制定的较为完善的研发工作流程制度，确保了研发活动的规范化开展以及研发成果的保护，为本项目的成功实施提供制度保障。

4、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为飞测思凯浦，计划投资总额 63,516.33 万元，其中拟投入募集资金 44,600.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资总额	占比	拟使用募集资金投资金额	占比
1	土地投资	1,574.44	2.48%	1,500.00	3.36%
2	建筑投资	22,901.09	36.06%	22,900.00	51.35%
3	设备及软件投资	10,252.14	16.14%	10,200.00	22.87%
4	预备费	1,657.66	2.61%	-	-
5	研发费用	27,131.00	42.71%	10,000.00	22.42%
合计		63,516.33	100.00%	44,600.00	100.00%

5、项目预计实施时间和整体进度安排

本项目的建设周期为 36 个月，包括项目前期准备及规划设计、工程施工、

设备采购、设备安装调试、技术研发及测试等 5 个阶段，设公司开始投资当年为 T+1 年，具体时间进度安排如下：

项目	T+1				T+2				T+3			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目前期准备及规划设计	■											
工程施工		■	■	■	■							
设备采购					■	■						
设备安装调试					■	■						
技术研发及测试						■	■	■	■	■	■	■

6、项目用地、涉及的审批、备案事项

本项目实施地点位于上海市浦东新区，建设用地上为新增土地。截至本预案公告日，相关用地、投资备案、环评（如需）等程序正在办理过程中。

（三）总部基地及研发中心升级建设项目

1、项目基本情况

本项目拟在深圳市龙华区建设集产品研发、日常办公、运营管理等功能为一体的总部基地，同时购置先进的软硬件设施，引入优秀技术人才，实现深圳研发中心优化升级，助力公司持续深入开展研发活动，提升技术研发实力。本项目的实施将实现公司集约化、系统化运营与管理，从而提高公司整体经营效益。与此同时，本项目的实施将对公司研发中心场地设施条件进行升级，满足公司前沿产品的研发需求，提高核心竞争力。

2、项目实施必要性

（1）充分发挥深圳市及大湾区集成电路产业集群优势及协同效应，促进公司高质量发展

本次募投项目建设地点位于深圳市龙华区。集成电路产业是深圳布局的重点产业集群之一，根据《深圳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，深圳市实施培育先进制造业集群行动，重点发展集成电路、智能制造装备等先进制造业集群。根据深圳市半导体行业协会数据，截至 2023

年末，深圳市共有集成电路企业 654 家，产业营收 2,136.8 亿元，同比增长 32.8%，已经形成全面覆盖设备、材料、设计、制造、封测等产业链环节的半导体产业集群。

本次募投项目拟开展公司总部基地及研发中心升级建设，充分利用深圳市及大湾区集成电路产业集群资源，吸引优质的技术、管理、销售等人才，更好的服务于公司未来高质量发展。

（2）提升公司基础设施水平，满足未来发展需要

公司凭借较强的技术创新能力、优异的产品品质以及出色的售后服务等积极因素，品牌认可度不断提升，客户群体覆盖度进一步扩大，经营规模快速增长。2021 年至 2024 年 1-9 月，公司营业收入分别为 36,055.34 万元、50,923.53 万元、89,090.01 万元、81,242.94 万元，呈现快速增长趋势。

目前，公司总部位于广东省深圳市，现有办公场地主要采用租赁方式取得，存在办公场所分散，协同及综合管理效率受限的情况。同时，随着产品结构的不断丰富及现有产品的持续迭代升级，公司现有研发条件已无法满足公司日益增长的前沿产品的研发需求，存在现有研发场地作业条件及研发功能拓展受限的情况，亟需建立一个基础设施完善先进、高效运营的总部基地，从而保证公司未来高质量可持续发展。

随着公司研发活动及业务经营的持续开展，公司总部基地有利于进一步改善研发场地设施条件，为员工提供稳定的研发和办公环境，实现集约化、系统化运营与管理，助力公司运营效率与研发效能提升，并进一步提升公司品牌形象。

（3）有效助推公司产品升级迭代，缩小与国际龙头设备厂商的差距

半导体质量控制设备行业属于典型的技术密集型行业，国际领先设备厂商通过持续的研发投入已经形成一定的技术优势。公司作为国内领先的半导体质量控制设备企业，始终致力于技术创新和产品性能提升，产品及技术已经形成较强的竞争优势，但与国际龙头设备厂商相比，在技术实力上仍存在一定差距。

本次募投项目的实施将在公司现有技术成果积累的基础上，持续加强研发投入，缩小与国际龙头厂商的技术实力差距，持续开展公司产品向高端前沿工艺领

域升级迭代，不断提高公司产品性能和核心技术指标，进一步推动我国半导体质量控制设备的国产化进程。

3、项目实施可行性

(1) 优质的产业生态及长期本地化经营积累为项目的实施提供了良好的环境与基础

深圳是我国经济发展最为活跃和创新能力最为突出的区域之一，长期致力于培育壮大具有核心竞争力的总部企业，打造具有国际影响力的产业集聚区。在打造优质集成电路产业生态方面，深圳已出台了诸多鼓励政策，在政策、技术和人才等配套保障方面具有突出的竞争优势。

公司成立并长期扎根于深圳发展，积累了丰富的本地化产业资源和优秀的人才队伍等经营所必要的资源，具有良好的社会声誉。产业资源方面，公司作为国内领先的半导体质量控制设备企业，与周边上下游合作伙伴形成了长期稳定的合作关系，以自身的高速发展带动供应商的共同成长，以快速的服务响应积累了良好的客户口碑；人才队伍方面，公司不断通过外部招聘及内部培养相结合的方式，构筑起了跨专业、多层次的人才梯队，核心团队高效稳定，人才体系健全合理；同时，良好的社会声誉与公司在后续经营发展中获得产业政策支持、吸引优秀人才、研发中心升级建设等方面形成良性循环。

综上，优质的产业生态及长期深耕本地经营积累为总部基地及研发中心升级建设项目在深圳地区的实施提供了良好的外部环境与基础。

(2) 丰富的技术储备为项目实施提供技术基础

公司作为国内半导体质量控制设备领域的佼佼者，高度重视优质研发资源的积累，尤其是行业优秀人才的引进以及高效、专业的研发团队的建设。公司通过在半导体检测技术、大数据检测算法和自动化软件领域的自主研发和不断创新，在多项半导体质量控制设备关键核心技术上达到国际领先水平，形成了集成电路制造过程中所有关键工艺环节所需的主要种类设备产品组合，使得公司能够为不同类型客户提供全面覆盖的检测和量测设备供应保障，支持客户的量产工艺需求和未来工艺研发需求。

依赖于公司前期丰富的研发资源积累和技术储备，公司将进一步重点专攻半导体质量控制前沿关键技术，大力推动国内半导体产业链在质量控制设备领域的自主可控，打破海外长期垄断局面。

(3) 健全的内部控制和治理机制为项目实施提供坚实的制度保障

随着公司规模和业务的快速发展，公司建立了较为完善的职能部门设置和管理体系，建立健全了良好稳定的内部决策程序和风险控制系统，持续不断提高公司管理水平，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略和内部控制等方面为公司业务发展提供精细化规划和决策，保证公司稳定、快速发展。

良好的职能部门内部建设和管理体系将有利于充分发挥不同职能部门的协同效应，实现总部集中化管理效益最大化，为公司总部未来良好稳定运行奠定基础。

4、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为中科飞测，计划投资总额 67,097.43 万元，其中拟投入募集资金 62,000.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资总额	占比	拟使用募集资金投资金额	占比
1	土地投资	2,980.00	4.44%	-	-
2	建筑投资	39,116.60	58.30%	39,100.00	63.06%
3	设备及软件投资	2,900.00	4.32%	2,900.00	4.68%
4	预备费	2,100.83	3.13%	-	-
5	研发费用	20,000.00	29.81%	20,000.00	32.26%
合计		67,097.43	100.00%	62,000.00	100.00%

5、项目预计实施时间和整体进度安排

本项目的建设周期为 36 个月，包括项目前期准备及规划设计、工程施工、设备采购、设备安装调试、技术研发及测试等 5 个阶段，设公司开始投资当年为 T+1 年，具体时间进度安排如下：

项目	T+1	T+2	T+3
----	-----	-----	-----

建设周期	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
项目前期准备及规划设计	■											
工程施工		■	■	■	■	■	■	■				
设备采购					■	■	■	■				
设备安装调试					■	■	■	■				
技术研发及测试								■	■	■	■	■

6、项目用地、涉及的审批、备案事项

本项目建设用地为新增土地，中科飞测已与深圳市规划和自然资源局龙华管理局签订《深圳市国有建设用地使用权出让合同》（深地合字（2023）4002号），土地用途为新型产业用地，公司已取得编号为粤（2023）深圳市不动产权第0552761号的不动产权证书。

本项目已取得深圳市龙华区发展和改革局出具的《深圳市企业投资项目备案证》（备案编号：深龙华发改备案[2024]887号）。

截至本预案公告日，本项目环评（如需）等事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行程序。

（四）补充流动资金

1、项目基本情况

公司本次募集资金拟使用 70,000.00 万元用于补充流动资金，有助于解决公司经营发展过程中对流动资金的需求，保障公司可持续发展。

2、项目实施必要性

公司所处行业为资金密集型行业，技术研发创新、生产运营、产品市场推广及相关服务都需要大量的持续资金投入。近年来，公司产品市场需求及订单保持良好增长态势，最近三年营业收入复合增长率为 57.19%，公司在原材料采购、薪酬支出、市场开拓等方面对营运资金的需求不断增加，加之存货、应收账款等经营性项目的资金占用规模亦随着收入快速增长呈现出相应增长，为了更好地开拓市场及支撑公司持续增长的采购需求，公司需要补充并维持一定规模的营运资

金以支撑未来经营规模的快速扩张。

3、项目实施可行性

公司本次发行募集资金用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具有可行性。本次发行募集资金用于补充流动资金有利于改善公司的资金状况，促进公司业绩增长，提升公司的盈利能力。

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，形成了规范有效的内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理和使用办法》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，确保本次发行的募集资金得到规范使用。

三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，有利于提高公司高端半导体质量控制设备研发和产业化能力，进一步提高公司在半导体质量控制领域的技术优势，丰富公司产品结构，增加资本规模和抗风险能力，降低财务风险，持续增强公司核心竞争力和盈利能力。

(二) 本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司资产总额将有所增加，营运资金得到进一步充实，资本结构将得到进一步优化，财务风险进一步降低。募投项目的实施也将进一步提升公司盈利能力，促进长期稳定发展。

四、可行性分析结论

本次募集资金投资项目包括上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目、总部基地及研发中心升级建设项目及补充流动资金，上述募投项目紧密围绕公司主营业务展开，是公司现有业务的延伸和补充，顺应行业市场发展方向，

符合公司业务布局及未来发展战略。

其中，上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目将进一步提升公司高端前沿工艺设备产业化能力，优化公司产品产能战略布局，进一步提升公司研发测试技术能力，进一步提高公司核心技术成果转化和产业化应用能力，不断推动公司产品技术升级迭代，持续增强公司核心竞争力，支撑公司高质量可持续发展。

总部基地及研发中心升级建设项目将进一步提升公司品牌形象，实现公司集约化、系统化运营与管理，并改善公司研发场地及软硬件设施，进一步提高研发效率、提升研发实力，满足前沿产品的研发需求。

补充流动资金可在一定程度上解决公司未来经营性现金流需求，降低公司财务风险，为公司经营规模快速增长提供相应的资金保障。

综上所述，本次募集资金投资项目是必要的、可行的。

深圳中科飞测科技股份有限公司

董事会

2024年12月7日